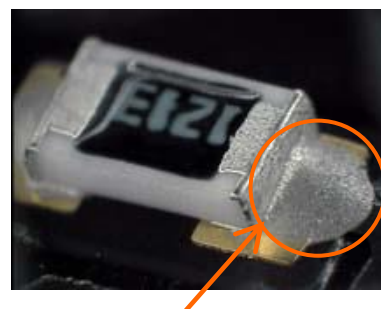


低温硬化 導電性接着剤

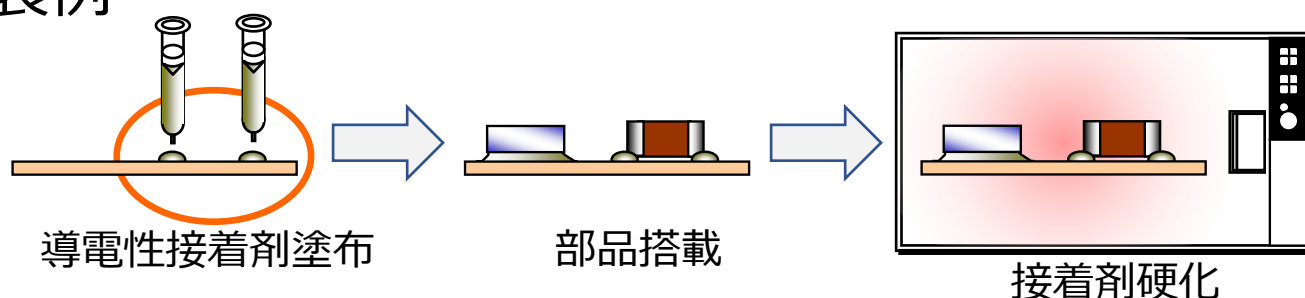
低温硬化プロセスにより、部品や基材の採用範囲を拡大

- 低温硬化(100 °C～180 °C)により、部品への熱ダメージを低減
- 銀フィラーによる良好な導電性
- ブリードアウトの原因となる溶剤を不使用



導電性接着剤

実装例



プロセス温度とプロセス時間

